

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

### 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	万家基金、长城基金
时间	2024年4月22日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1.公司今年Q1营收增速强势，请帮忙分析下公司的下游客户结构以及营收增长的原因？对Q2业绩的整体展望是什么？</b></p> <p>整体来看，公司营收主要来自消费电子/工规/车规等领域。具体来看，IoT类客户占比50%左右，PA类占比20%左右，安防领域占比10%~15%，运算领域客户和汽车电子领域的营收绝对占比较低，但增速较快。</p> <p>得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展及部分原有客户的份额提升，公司2024年一季度营收实现71.77%的同比增长。</p> <p>公司目前对二季度的营收增长趋势是比较乐观的。</p> <p><b>2.公司目前积极拓展台系客户，面对台系客户，公司的竞争优势是什么？</b></p> <p>公司原有客户以细分领域的龙头设计公司为主，已在多个领域展现出良好的竞争力，充分表明公司具备进入海内外细分领域龙头设计公司供应链的实力。同时，客户基于多种考虑在寻求供</p>

应链本土化，公司在发展的过程中与台湾地区的头部客户也存在业务合作。从商务角度来说，在技术水平接近的情况下，公司在成本、交期、服务、稳定性等方面都具有一定的竞争优势。

### **3.公司预计何时迎来盈利拐点？**

去年四季度公司已经实现了单季度盈利，一季度受春节假期/淡旺季需求等影响营收环比略有下滑，整体业绩也有所亏损，但展现出了强劲的增长势头。未来，公司的毛利率取决于两个方面，一方面是订单的价格，这个最终取决于市场恢复的一个程度。另一方面，对于公司二期新增的投资，虽然公司的稼动率属于比较饱满状态，但产能存在一个爬坡的过程，同时为新增投资提前储备了生产端的人员以及水电能源等成本，对于公司的毛利率有一定的影响。随着公司营收规模的扩大，规模效应会逐渐体现，会摊掉更多的成本，对盈利情况也有一定的正向提升作用。

### **4.公司目前的产能情况及未来的产能布局？**

公司不同产品产能均有所扩充。具体而言，Bumping/WLCSP 是新产线，全部为新增产能；同时，原有的 SiP 类产品/QFN 类产品的市场需求持续回暖，包括应用于 PA 领域的模组类 SiP 封装、双圈 QFN 等新的需求也在增加，公司将根据市场情况在原有的基础上继续增加产能。

公司坚持中高端先进封装定位，持续加大研发投入，一方面，公司推进成熟产线的扩产，另一方面，积极布局先进封装和汽车电子领域，按市场需求稳步推进包括 Bumping、晶圆级封装、FC-BGA、汽车电子的 QFP 等新产品线布局。

### **5.公司目前稼动率水平？**

目前公司的稼动率处于相对饱满的状态。

### **6.23 年公司投资规模与投资领域？未来的资本开支计划？**

去年公司投资 30 亿左右，主要投资于厂房和设备，应用于 Pamid 模组、FC、CP、Bumping 领域。

今年预计资本开支在 25 个亿左右。

	<p><b>7.公司 2023 年折旧摊销情况？ 未来折旧趋势展望？ 公司营收达到什么水平可以覆盖折旧？</b></p> <p>根据公司 2023 年的财报，公司全年折旧及摊销在 5.3 亿左右。随着在建工程逐步转固，公司未来的折旧金额会逐步增长；但公司营收规模持续保持快速增长，随着规模效应的逐渐显现，预计会对整体盈利水平呈现正面影响。</p> <p><b>8.公司目前在手订单的情况？ Q2 订单的展望？</b></p> <p>行业的 Forecast 一般在 3 个月左右。</p> <p>公司对 Q2 订单增长情况相对乐观。</p> <p><b>9.公司对未来价格的展望？</b></p> <p>目前整体上价格相对稳定，后续价格变动最终取决于整个市场的供求和本身产品的工艺难度。</p> <p>从公司的观察看，公司稼动率处于比较饱满的状态。公司的稼动率反映了市场真实的需求，价格已处于一个相对的低位，价格普遍下调阶段已结束。随着未来整体宏观经济的回暖，公司相信价格应该会有边际向好的趋势。</p> <p><b>10.公司先进封装的布局情况？</b></p> <p>公司通过实施 Bumping 具备了 RDL 能力并且已经量产，Fan-in 研发成功，Fan-out 进展顺利。公司也在积极布局 2.5D/3D 领域，并与一些客户保持交流。</p> <p><b>11.公司车规领域客户拓展进度？</b></p> <p>公司重点发展车规、工规产品线，在汽车电子领域的产品在智能座舱、车载 MCU、图像处理芯片等多个领域通过了终端车厂及 Tier 1 厂商的认证。因为车规工规的品质要求也会相对严格，整体的认证的周期也较长，需要公司持续地进行精耕细作，目前整体收入占比相对较低。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 4 月 22 日